

# 工程リスト作成アプリの使い方

\* 本アプリは、HTML形式ですので、WebBrowser上で動作し安全です。

Tabで装置の大分類を選択ください。

基板工程 Wafer 実装・検査 その他

表示行数: 48

選択行程

21B : プリント基板用直接描画装置  
28 : ソフトエッチ水洗装置  
36 : 基板用無電解めっき装置  
29 : レジスト剥離装置  
30 : プリント基板用プラズマクリーナー

ドラッグ & ドロップで  
行移動出来ます。

21B : プリント基板用直接描画装置  
29 : レジスト剥離装置  
36 : 基板用無電解めっき装置  
4 : プリント基板穴開機(ドリル加工機)  
36 : 基板用無電解めっき装置  
34 : 積層前粗化処理装置  
29 : レジスト剥離装置  
7 : 乾燥炉DE610(260°C-B)

カーソールを所定の行に移動し  
クリックすると「行選択」モードに  
なり行の背景が緑色になります。  
もう一度行をクリックすると  
「行選択」モードは解除され、背景  
は無色になります。

選択装置にカーソールを合わせ  
クリックすると右の「選択行程」  
に装置が追加されます。

2 : プリント基板真空プレス装置  
・機 ----- 機械加工

----- Data Area -----  
(右欄[選択行程])  
\* Clikで行を指定  
\* 再Clikで解除  
\* 要素追加は、  
最後の行もしくは、  
指定行に追加される  
\* 行削除も同様。

21B : プリント基板用直接描画装置  
9 : 予熱ラミネーター(ロールラミネーター)  
11 : クリーンローラ  
12 : フィルムレジスト圧着装置(真空ラミ)  
21B : プリント基板用直接描画装置  
30 : プリント基板用プラズマクリーナー  
7 : 乾燥炉DE610(260°C-B)  
23 : 乾燥炉DT610(360°C-B)  
・水 ----- 水平ライン(現像/エッ칭)  
13 : 乾燥炉DE610(260°C-水平ライン)  
27 : 基板用現像装置  
28 : ソフトエッチ水洗装置  
29 : レジスト剥離装置  
31 : 基板用ケミカルエッキング装置  
57 : 基板用Ni/Auめっき  
・め ----- めっきライン  
25 : 基板用バフ研磨装置  
34 : 積層前粗化処理装置  
35 : デスマニア装置

選択装置にカーソールを合わせ  
クリックすると右の「選択行程」  
に装置が追加されます。

2 : プリント基板真空プレス装置  
・機 ----- 機械加工

20 : プリント基板用UVUVCOAT一括加工機

ファイルへ保存  
ファイルを選択 選  
ファイルを選択  
行程表を Clear  
Clear取り消し  
行削除 取消

## 【選択工程欄の編集】

- 通常モード（非行選択モード）では、選択した装置は最後の行に追加されます。
- 通常モードでは、[行削除]で最後の行が削除されます。  
[取消]で、直前の削除が取り消されます。
- 行選択モードでは、選択された背景が緑色になった行に、「装置が追加される」  
もしくは、「選択行が削除」される様になります。
- 上記に示す様に、ドラッグ & ドロップで行の内容を移動できます。
- [行程表をClear]で行程表をクリア出来ます。  
また、[Clear取り消し]で直前のClearを取り消すことが出来ます。
- 作成した内容は、[ファイルへ保存]を押すと「ダウンロード」フォルダーに  
「ProcessData.csv」の名前で保存されます。  
追加で保存しても重ね書きされずに「ProcessData(1).csv」の様にネーミングされます。  
適当なファイル名に変更し保存してください。内容はCSV形式ですので可読です。  
**このファイルは、そのまま「センター予約システム」に読み込める**。
- [ファイルを選択]ボタンを押すと、ファイル選択ダイアログが表示されますので、  
保存したファイルを読み込み、再度編集する事が出来ます。
- 表示行数[48] の入力項で、各Tabリストの表示行数を変更可能です。